



FATC 記憶體最佳代工夥伴

福懋科技 2022年法人說明會

總經理暨發言人 張憲正

2022年12月12日

免責聲明

簡報內容（含本會議中所揭露之資訊）含有若干預測性資訊，僅供參考之用。福懋科技股份有限公司或任何第三人均不就該預測性資訊之正確性與完整性承擔任何責任，亦不負更新或更正該資訊之義務，請您務必謹慎審閱以上資訊。如未經許可，亦請您切勿散播、重製或揭露以上資訊之一部分或全部予第三人。

會議議程

- 1 2022年前三季營運績效及財務狀況
- 2 研究發展規劃
- 3 營運重點與市場展望
- 4 問與答

1

2022年前三季 營運績效及財務狀況



2022年前三季財務摘要

單位:新台幣仟元

會計科目	項目	2022年Q1~Q3		2021年Q1~Q3		差異	
		金額	%	金額	%	金額	%
營業收入		7,932,504	100.0	7,449,895	100.0	482,609	6.5
營業毛利		1,681,671	21.2	1,494,618	20.1	187,053	12.5
營業利益		1,497,839	18.9	1,335,559	17.9	162,280	12.2
稅前息前折舊攤銷前利益		3,144,830	39.6	2,492,576	33.5	652,254	26.2
稅前淨利		2,174,407	27.4	1,394,811	18.7	779,596	55.9
本期淨利		1,773,263	22.4	1,133,452	15.2	639,811	56.4
每股盈餘(元/股)		4.01		2.56		1.45	
每股淨值(元/股)		28.06		26.88		1.18	

2022年各季綜合損益表

單位:新台幣仟元

會計科目	項目	2022年Q3		2022年Q2		2022年Q1	
		金額	%	金額	%	金額	%
營業收入		2,670,776	100.0	2,699,094	100.0	2,562,634	100.0
營業毛利		559,455	20.9	608,027	22.5	514,189	20.1
營業利益		497,628	18.6	550,626	20.4	449,585	17.5
稅前息前折舊攤銷前利益		1,092,354	40.9	1,149,039	42.6	903,437	35.3
稅前淨利		773,095	28.9	824,888	30.6	576,424	22.5
本期淨利		626,817	23.5	685,307	25.4	461,139	18.0
每股盈餘(元/股)		1.42		1.55		1.04	
每股淨值(元/股)		28.06		27.17		28.74	

2022年第3季與第2季差異說明

單位:新台幣仟元

項目	2022年Q3		2022年Q2		差異		差異說明
	金額	%	金額	%	金額	%	
會計科目							
營業收入	2,670,776	100.0	2,699,094	100.0	-28,318	-1.0	銷售量季減中個位數百分比，平均代工單價增加低個位數百分比，匯率影響有利低個位數百分比。
營業毛利	559,455	20.9	608,027	22.5	-48,572	-8.0	2022年Q3毛利季減8.0%，主要係銷售量減少中個位數百分比。
營業利益	497,628	18.6	550,626	20.4	-52,998	-9.6	2022年Q3營業利益季減52,998仟元，主要為毛利減少48,572仟元、推銷管理費用增加885仟元及研發費用增加3,541仟元。
本期淨利	626,817	23.5	685,307	25.4	-58,490	-8.5	本期淨利季減58,490仟元，主要為營業利益減少52,998仟元、利息收入增加7,043仟元、兌換利益增加102,958仟元、股利收入減少87,444仟元、其他損失增加19,617仟元及所得稅費用增加6,697仟元。

現金流量表

2022年前三季現金流量

單位:新台幣仟元

	2022年Q3	2022年Q2
期初餘額	4,769,275	4,118,337
營業活動之現金流量	1,068,951	716,433
資本支出	-214,783	-37,941
其他	-14,843	-27,554
股利支出	-1,105,403	0
期末餘額	4,503,197	4,769,275
自由現金流量	854,168	678,492

營業活動之現金流量



資本支出

-437,961

其他

-41,308

股利支出

-1,105,403

3,594,418

2022/1/1
期初餘額

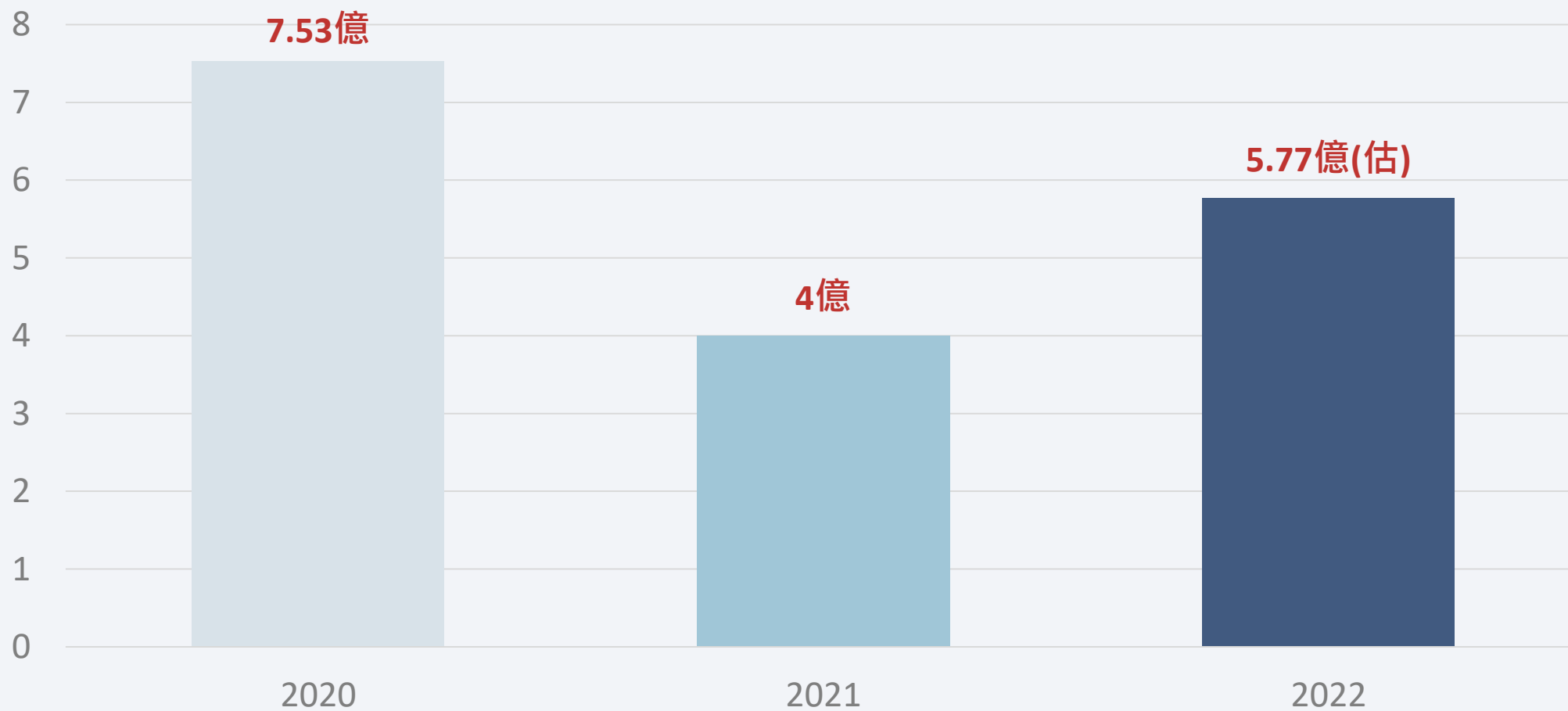
4,503,197

2022/9/30
期末餘額

2022年前三季自由現金流量為2,055,490千元

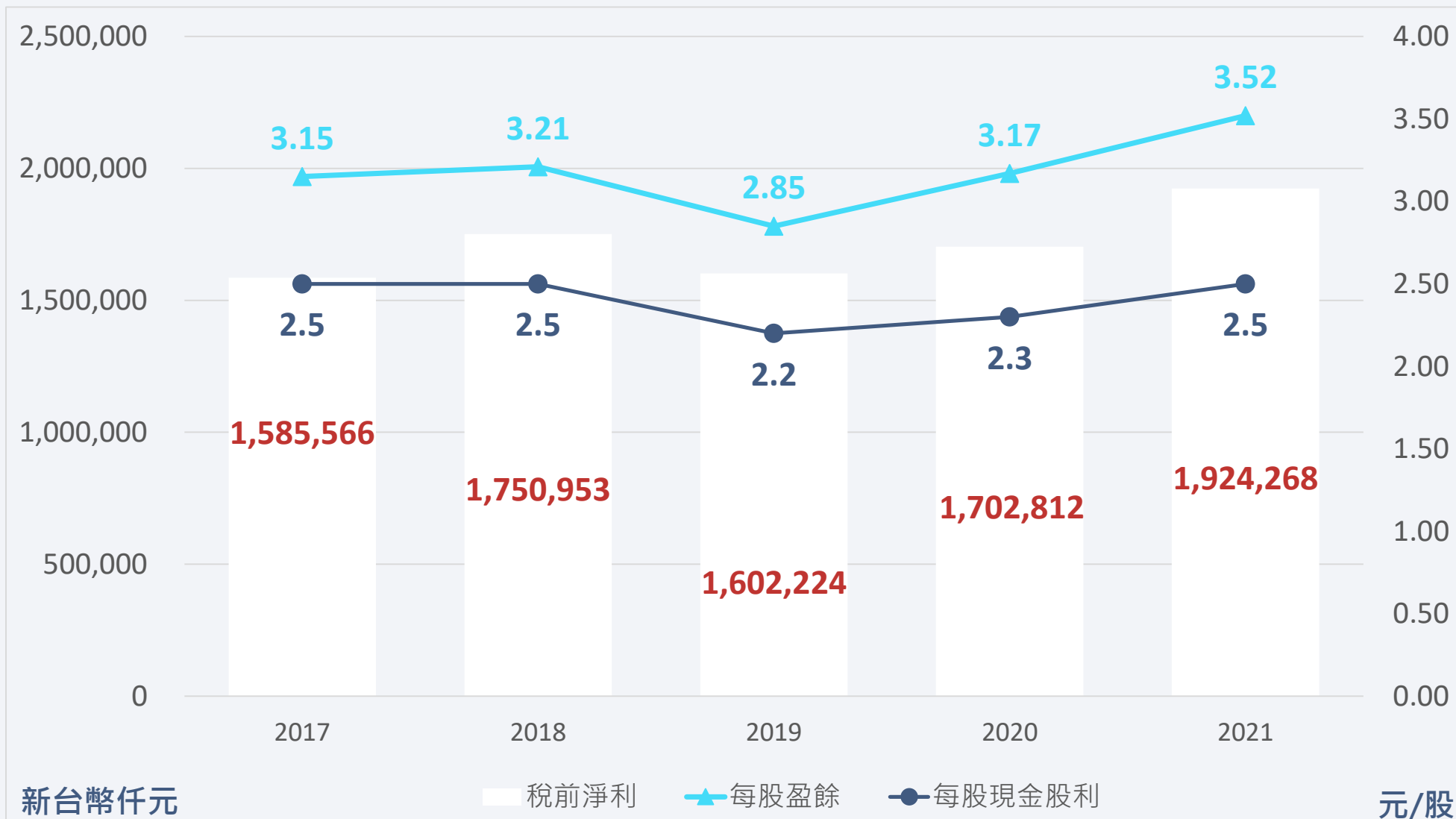
歷年資本支出

單位:新台幣億元

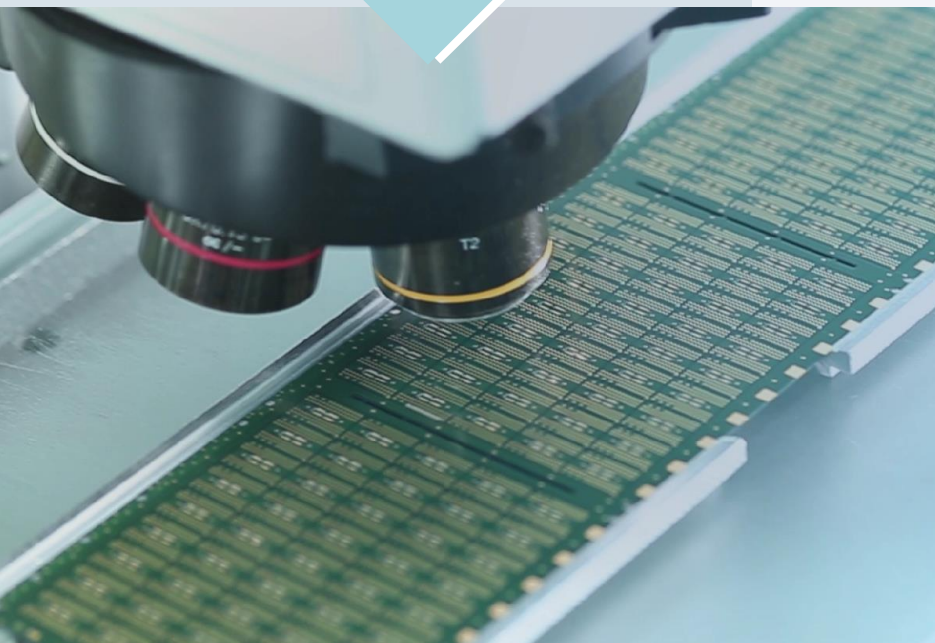


近5年之稅前淨利、稅後EPS、現金股利

單位:新台幣仟元



2



研究發展 與規劃

研究發展與規劃

記憶體：終端產品需求及記憶體晶片製程微縮並朝向高效能發展，福懋科技依此趨勢擬訂研發方向如下：

1

因應終端產品記憶體高速運算需求，將專注於DDR5產品開發，強化載板電路設計、高腳數銅凸塊結構及微間距封膠，朝低訊號延遲和低耗能等技術發展，以強化覆晶封裝技術能力。

2

將記憶體產品所用的錫線及覆晶等技術，延伸應用至邏輯產品領域。

3

營運重點與 市場展望



營運重點

1

受高通膨及全球整體經濟情勢趨緩影響，電子產品需求疲弱，客戶庫存水位升高，致封測代工量減少。因應市場變化採彈性調整產能、縮短生產交期以滿足客戶需求。

2

記憶體產業短期雖有波動，但長期因人工智慧、物聯網、5G、VR、汽車的廣泛應用，未來需求將持續成長。所以福懋科持續進行擴建，新建五廠於今年11月9日動土興建，預計2025年量產，佈局覆晶技術及DDR5產品。

市場展望

1

2022年下半年記憶體市場需求疲弱，主因戰爭、通膨、升息與地緣政治等因素，致消費緊縮，影響電子產品需求，手機、筆電、消費性電子產品需求均疲弱，連帶影響電子產品製造廠對記憶體的備貨。

2

另外，由於全球整體經濟情勢下行，數據中心建置速度放緩，影響伺服器記憶體需求。網路通訊與工控需求則相對較穩定。

3

面對低需求高庫存的狀況，客戶減少投片或存放晶圓庫存以調節成品庫存，預估明年2Q以後，庫存逐漸去化、需求回升後，可望逐漸恢復。

4

問與答

